

**Données OMNIMATE - Prises RJ45
RJ45C5 S1V 2.7N4N RL**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



La gamme de produit comprend les conceptions suivantes :

- 90°, couché (horizontal) et 180°, debout (vertical)
- verrouillage / déverrouillage
- Systèmes de soudure THT, THR ou SMD
- Large gamme de formes, également avec des LED intégrées et des languettes de contact blindage
- Catégorie de puissance Cat. 3 à Cat. 6
- Version emballée sur plateau (TY) ou en rouleau (Tape-on-Reel, RL)

Propriétés et avantages :

- Plage de température étendue de -40 °C à +85 °C, pour une puissance maximale
- Couche d'or renforcée (30µ") pour une protection contre la corrosion améliorée
- une distance minimale de 3 mm garantit une soudure parfaite

Informations générales de commande

Type	RJ45C5 S1V 2.7N4N RL
Référence	1433900000
Version	Connecteur pour circuit imprimé, Prises RJ45, Cat. 5 , Raccordement soudé SMD, 180°, Languettes de blindage: aucun, 30-80 µ" Ni / 30- µ" Au , LED: Non, Nombre de pôles: 8, Tape
GTIN (EAN)	4050118238587
Cdt.	300 pièce(s)
Emballage	Tape

**Données OMNIMATE - Prises RJ45
RJ45C5 S1V 2.7N4N RL**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Dimensions et poids**

Largeur	16,1 mm	Largeur (pouces)	0,634 inch
Hauteur	13,2 mm	Hauteur (pouces)	0,52 inch
Hauteur version la plus basse	13,2 mm	Profondeur	20,05 mm
Profondeur (pouces)	0,789 inch	Poids net	3,467 g

Températures

Température de fonctionnement , max.	85 °C	Température de fonctionnement , min.	-40 °C
Température de stockage, max.	85 °C	Température de stockage, min.	-40 °C

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Caractéristiques du système

Angle de sortie	180°	Blindage	Oui
Catégorie	Cat. 5	Circuit	8 brins
Cycles d'enchâssage	750	Degré de protection	IP20
Famille de produits	Données OMNIMATE - Prises RJ45	LED	Non
Languettes de blindage	aucun	Longueur du picot à souder (l)	3,5 mm
Matériau de blindage	Alliage de cuivre	Montage sur le circuit imprimé	Raccordement soudé SMD
Nombre de picots par pôle	1	Nombre de pôles	8
Pas en mm (P)	1,27 mm	Pas en pouces (P)	0,05 inch
Surface de blindage	nickelé	Type de raccordement	Femelle

Propriétés électriques

Courant nominal	1,5 A	Rigidité diélectrique, contact - contact	≥ 1000 V DC
Tension nominale	125 V AC	Tenue d'isolation	> 500 MΩ

Données des matériaux

Matériau isolant	PA 9T	Couleur	noir
Tableau des couleurs (similaire)	RAL 9011	Groupe de matériaux isolants	II
CTI	≥ 500	Tenue d'isolation	> 500 MΩ
Moisture Level (MSL)	1	Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0
Matériau de base du contact	Bronze phosphoreux	Surface du contact	Or sur nickel
Structure en couches du raccordement soudé	30-80 µ" Ni / 30- µ" Sn	Structure en couches du contact mâle	30-80 µ" Ni / 30- µ" Au
Température de stockage, min.	-40 °C	Température de stockage, max.	85 °C
Température de fonctionnement , min.	-40 °C	Température de fonctionnement , max.	85 °C

Emballage

Emballage	Tape	Longueur VPE	50 mm
Largeur VPE	330 mm	Hauteur VPE	330 mm
Diamètre de bobine du ruban Ø (A)	330 mm	Résistance de la surface	Rs = 10 ⁹ - 10 ¹² Ω

**Données OMNIMATE - Prises RJ45
RJ45C5 S1V 2.7N4N RL****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Classifications**

ETIM 6.0	EC002637	eClass 6.2	27-25-05-04
eClass 7.1	27-25-05-04	eClass 8.1	19-17-01-25
eClass 9.0	27-44-04-02	eClass 9.1	27-44-04-02

Agréments

Agréments



ROHS

Conforme

Téléchargements

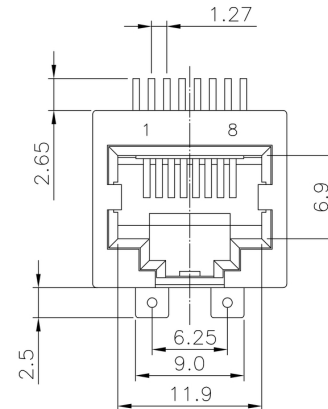
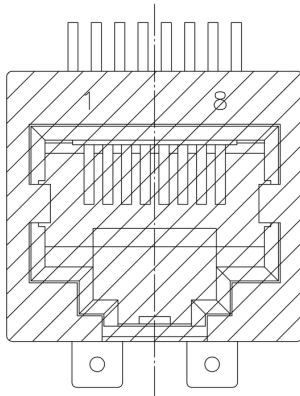
Brochure/Catalogue	CAT 9 IETH 15/16 EN MB FREECONTACT EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN
Documentation utilisateur	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN

Données OMNIMATE - Prises RJ45 RJ45C5 S1V 2.7N4N RL

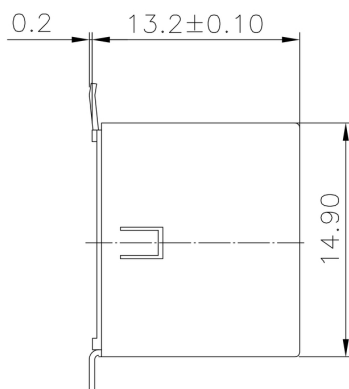
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dessins

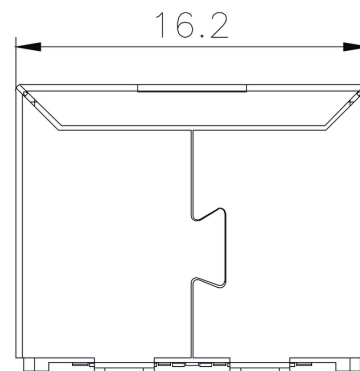
Dessin coté



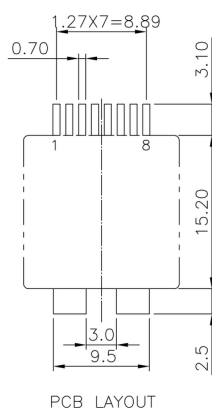
Dessin coté



Dessin coté



Dessin coté



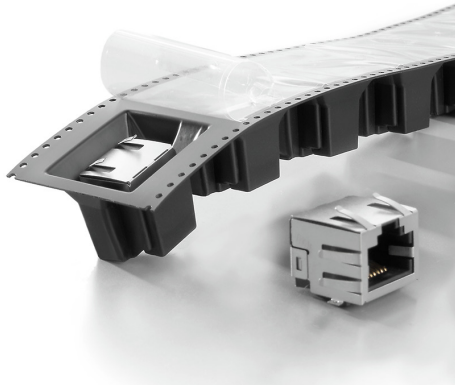
Dessin coté

Données OMNIMATE - Prises RJ45 RJ45C5 S1V 2.7N4N RL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dessins

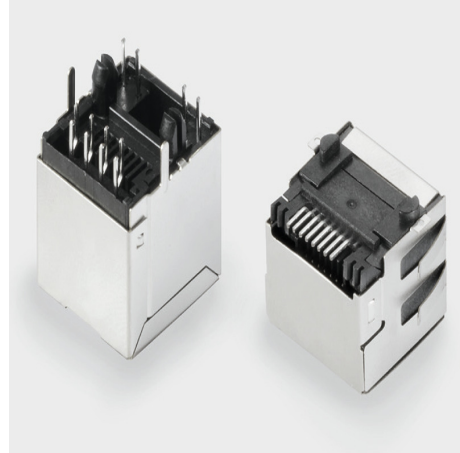
Avantages produit



Process-optimised packaging
Tape-on-reel or tray

Avantages produit

Avantages produit



Trouble-free assembly
Short, chamfered solder pins



Suitable for all soldering processes
SMT, THT or THR

Fiche de données

Données OMNIMATE - Prises RJ45 RJ45C5 S1V 2.7N4N RL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmuller.com

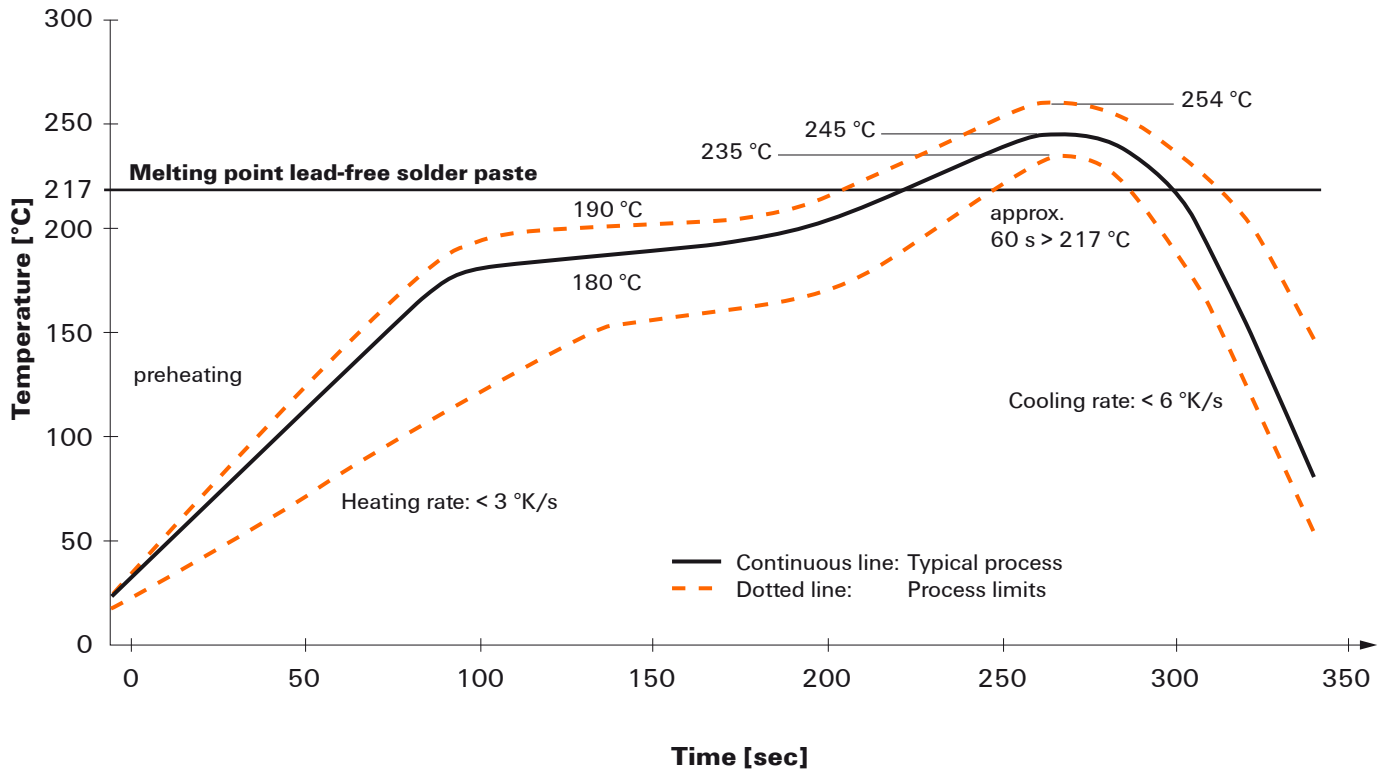
Dessins

Légende

RJ45	G1	R	1	U	3.2	E	4	GY/GY	TY	RJ45G1 R1U 3.2E4GY/GY TY

Recommended reflow soldering profile

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Reflow soldering profile

The perfect soldering profile for SMT Surface Mount Technology is one the most exiting question in SMT production. But there are more than one correct answer: The diagram of temperature-on-time is related to processing features of solder paste and to maximum load of components.

We have to consider the following parameters:

- Time for pre heating
- Maximum temperature
- Time above melting point
- Time for cooling
- Maximum heating rate
- Maximum cooling rate

We recommend a typical solder profile with associated process limits. With preheating components and board are prepared smoothly for the solder phase. Heating rate is typically $\leq +3\text{K/s}$. In parallel the solder paste is 'activated'. The time above melting point of 217°C the paste gets liquid and components and boards begin to connect. The maximum temperature of 245°C to 254°C should stay between 10 and 40 seconds. In the cooling phase at $\geq -6\text{K/s}$ solder is cured. Board and components cool down while avoiding cold cracks.